

平成 18年 4月 28日

各 位

会 社 名 株式会社 テセック
 代表者名 代表取締役社長 大塚 英樹
 (J A S D A Q ・ コード 6 3 3 7)
 問い合わせ先 取締役経理部長 矢崎 七三
 T E L 0 4 2 - 5 6 6 - 1 1 1 1

平成18年3月期通期業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績の動向を踏まえ、平成17年11月15日に公表しました平成18年3月期(平成17年4月1日～平成18年3月31日)の業績予想を下記のとおり修正いたします。

記

1. 平成18年3月期連結業績予想の修正(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成17年11月15日発表)	5,200	400	170
今回修正予想(B)	4,580	7	220
増減額(B - A)	620	407	390
増減率	11.9%	-	-
(ご参考) 前期(平成17年3月期)実績	5,612	555	527

2. 平成18年3月期単体業績予想の修正(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

(単位:百万円)

	売上高	経常利益	当期純利益
前回発表予想(A) (平成17年11月15日発表)	4,800	350	150
今回修正予想(B)	4,220	60	240
増減額(B - A)	580	410	390
増減率	12.1%	-	-
(ご参考) 前期(平成17年3月期)実績	5,333	461	460

3. 修正理由

半導体業界は、在庫調整の一巡により新規設備投資が加速され下半期より半導体製造装置需要は国内、北米、アジアなど主要地域で拡大基調で推移しました。

このような状況の中で、堅調な需要拡大が期待される小信号デバイス用ハンドラ市場に世界最速レベルの新製品を投入するなど、国内外市場で受注拡大に注力した結果、第3四半期より、受注状況は回復基調に転じましたが、上半期の受注不振をカバーするには至らず、売上高は計画比未達となりました。

損益面につきましても、価格競争激化や稼働率低下に伴う製造原価の上昇などにより、連結・単体業績とも前回予想を下回り、経常損失および当期純損失を計上する見込みであります。

なお、期末配当につきましては、前回予想のとおり1株当たり20円を予定しており、変更はございません。

以 上